

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2023-024

## 深圳天德钰科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议并通过了《关于首次公开发行募投项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等情况，同意公司对募投项目“移动智能终端整合型芯片产业化升级项目”、“研发及实验中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划2023年5月延期调整为2024年6月。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人对本事项出具了核查意见，该事项在董事会审批权限范围内无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年7月14日出具《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,055.56万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格21.86元，募集资金总额为人民币87,924.54万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币78,400.53万元。上述募集资金已于2022年9月到账，由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年9月22日出具了“毕马威华振验字第2201379号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

## 二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金累计投入金额	累计投入比例
1	移动智能终端整合型芯片产业化升级项目	27,929.73	13,404.07	47.99%
2	研发及实验中心建设项目	9,947.30	4,783.98	48.09%
合计		37,877.03	18,188.05	48.02%

## 三、本次募投项目延期的具体情况及原因

### （一）本次募投项目延期情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	达到预定可使用状态日期	
		变更前	变更后
1	移动智能终端整合型芯片产业化升级项目	2023 年 5 月	2024 年 6 月
2	研发及实验中心建设项目	2023 年 5 月	2024 年 6 月

### （二）本次募投项目延期的原因

公司首次公开发行募投项目“移动智能终端整合型芯片产业化升级项目”“研发及实验中心建设项目”原计划建设周期为 24 个月，上述项目于 2021 年立项规划建设周期，公司首次公开发行股票募集资金到账时间为 2022 年 9 月 22 日。项目建设计划支出中包含的场地基础建设、物料采购、设备购置等由于受到募集资金到账时间晚于初始预期等因素的影响，使项目在资金投入上出现时间差，导致项目建设进度较原计划有所滞后。

#### 四、本次延期募投项目的必要性和可行性

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》相关规定：“超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到计划金额 50%，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此公司对“移动智能终端整合型芯片产业化升级项目”、“研发及实验中心建设项目”的可行性和必要性进行了重新论证：

##### （一）移动智能终端整合型芯片产业化升级项目

###### 1、项目必要性分析

近年来，移动智能终端领域的迅速发展对行业相关技术提出了更高的要求。智能终端、消费电子领域的快速发展，催化出容量更大的未来市场，行业成长空间巨大，市场的飞速发展对相关驱动芯片的技术提出了更高的要求。除市场需求的推动外，集成电路设计行业的技术更新迭代也不断加快，并且受境外政治因素的影响，中国政府大力支持本土集成电路公司的自主研发，这些都促使行业内公司加速推陈出新，以保持技术持续更新。在公司产品在细分行业内，智能移动终端显示屏驱动芯片、摄像头音圈马达驱动芯片主要龙头厂商集中在中国台湾地区及韩国等国家和地区，快充协议芯片、电子标签驱动芯片领域虽然在中国境内居细分行业前列，但在全球范围内的细分行业领域仍有上涨空间。因此，项目的实施有助于公司对新产品进行进一步的研发及产业化，从而保证公司技术上的延续性和前瞻性，为相关细分领域新产品、新技术的发展提供保障。

本项目将针对公司已有的细分领域产品进行新产品的产业化建设，在智能移动终端显示驱动芯片领域，公司将对触控与显示驱动集成芯片（TDDI）、AMOLED 类可穿戴显示驱动 IC、新一代全屏下指纹识别类芯片（FDDI）和 5G 环境下应用的 VR 类显示驱动芯片等进行技术开发和产业化生产，扩展原有显示驱动芯片的应用领域，并通过技术提升进一步降低成本；在摄像头音圈马达驱动系列芯片领域，公司将进一步对记忆金属马达（SMA）驱动芯片和光学防抖（OIS）驱动芯片进行技术开发和产业化生产，以满足高中低阶智能手机市场的需求；在快充协议系列芯片领域，公司将在原产品的基础上，继续进行 USB-A+USB-C 双口整合型、多协议快充 IC 等产业化发生，提升公司在快充协议 IC 领域的行业地位；在电子标签驱动芯片领域，公司将在现有产品的基础上，进一步提升产品性能，拓展产

品在新零售领域的应用范围。综上，公司通过本项目的实施，能够提升产品性能、扩大产品应用领域，且能够优化成本，从而提升在移动智能终端领域的市场份额和竞争力。

## 2、项目可行性分析

(1) 项目建设内容符合国家产业政策集成电路行业为我国重点支柱产业，近年来，相关政府及主管部门相继出台支持行业发展的产业、税收优惠、投融资、人才支持等政策。本项目建设内容为公司现有芯片产品的产业化生产，符合国家产业政策方向，相关产业支持政策也将为本项目的实施提供有力支持。

(2) 公司注重技术研发和积累，已形成了多项核心技术。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共拥有专利 62 项，其中发明专利 58 项、实用新型专利 4 项，涵盖本项目各产品领域。公司扎实的技术积累为本项目的实施提供了有力的技术支持。同时，公司注重人才培养，建立了完善的人才培养及激励机制，培养了完整的研发团队。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共拥有研发人员 188 人，占公司员工总数的 72.59%，为本项目的实施提供坚实的人员保障。

(3) 公司具备良好的客户及供应链资源公司深耕集成电路设计行业多年，积累了稳定良好的客户及供应链资源。客户方面，公司与多家电子元器件代理商建立了稳定的合作关系，且与行业内知名模组厂、面板厂、方案商和终端客户建立了长期稳定的业务关系；供应链方面，公司与行业内领先的晶圆制造商和封装测试商均建立了稳定的合作关系，为本项目的产业化实施提供有效的产能基础。综上，公司拥有的良好客户及供应链资源为本项目的实施提供了有力保障。

## 3、重新论证结论

公司认为“移动智能终端整合型芯片产业化升级项目”符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关条件变化，适时安排募集资金项目的投资。

### (二) 研发及实验中心建设项目

#### 1、项目必要性分析

(1) 实现关键技术国产化的需要集成电路产业为电子信息等众多科技产业的基础性产业，对其他重要行业的发展具有重要作用。我国集成电路企业起步较晚，部分核心技术仍集中在少数国家手中。公司常年深耕移动智能终端领域的整

合型单芯片研发、设计、销售，在智能移动终端显示屏驱动芯片、摄像头音圈马达驱动芯片、快充协议芯片、电子标签驱动芯片领域均有一定建树，具备了一定的进口替代能力，但与各细分领域的领头企业仍存在一定的技术差距。本项目通过新设研发中心、引进高端技术人才，加强对各领域产品和技术的研究，有利于公司更快响应市场需求，及时提升技术实力，实现部分高阶技术的国产化，也有助于推动公司提升市场地位。

(2) 有利于改善研发环境、引进高端人才公司是 Fabless 芯片设计公司，对于员工的专业能力有着极高的要求，现有研发团队具备扎实的技术实力，在移动智能终端领域的整合型单芯片的研发设计具有丰富经验。但随着公司规模扩大及市场需求的多样化、细分化，公司亟需引入适当的研发人员以满足项目研发的需要。但目前国内集成电路设计行业人才较为匮乏，因此，公司需要整合现有资源、不断完善研发中心建设，从而吸引更多高端技术人才，以提高公司整体研发水平、助力公司长期可持续发展。

## 2、项目可行性分析

### (1) 项目建设内容符合国家产业政策

集成电路行业为我国重点支柱产业，近年来，相关政府及主管部门相继出台支持行业发展的产业、税收优惠、投融资、人才支持等政策。本项目建设内容为公司现有芯片产品涉及的新技术和方向的研究，符合国家产业政策方向，相关产业政策也将为本项目的实施提供有力支持。

### (2) 公司具备项目实施的技术团队和技术基础

公司注重技术研发和积累，已形成了多项核心技术。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共拥有专利 62 项，其中发明专利 58 项、实用新型专利 4 项，涵盖本项目各产品领域。公司扎实的技术积累为本项目的实施提供了有力的技术支持。同时，公司注重人才培养，建立了完善的人才培养及激励机制，培养了完整的研发团队。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共拥有研发人员 188 人，占公司员工总数的 72.59%，为本项目的实施提供坚实的人员保障。

### (3) 公司健全的研发管理制度为项目实施提供保障

公司注重研发建设及管理，建立了完善的研发机构和管理制度。目前，公司研发机构包括类比设计处、数位研发处、系统模拟处、技术支援处、电脑辅助设

计处、系统验证处，能够满足项目研发各个环节的要求。同时，公司制定了完善的研发管理制度，对项目研发环节及流程进行规范管理。此外，公司注重研发投入，2020年至2022年公司研发费用分别为5,652.60万元、13,116.60万元、14,962.66万元，研发投入持续稳定增长。

综上，公司健全的研发机制、管理支持和稳定持续的研发投入为本项目实施提供了有力保障。

### 3、重新论证结论

公司认为“研发及实验中心建设项目”符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关条件变化，适时安排募集资金项目的投资。

## 五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

## 六、专项意见说明

### （一）独立董事意见

公司独立董事认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。项目的延期末改变募集资金投资项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

### （二）监事会意见

监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。综上，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

### （三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不涉及募投项目的建设内容、投资规模、用途的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序，公司本次募投项目延期符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023年8月26日